

锦州神工半导体股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 9 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，现对公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金规模进行调整。具体如下：

原内容：

募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	硅零部件扩产项目	57,747.25	50,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
2	碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目	30,138.46	30,000.00
3	研发中心建设项目	20,643.13	20,000.00
合计		108,528.84	100,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整为：

募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 81,028.32 万元（含 81,028.32 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入扣除发行费用后的募集资金净额
1	硅零部件扩产项目	57,747.25	41,369.28
2	碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目	30,138.46	23,659.04
3	研发中心建设项目	20,643.13	16,000.00
合计		108,528.84	81,028.32

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对《锦州神工半导体股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对《锦州神工半导体股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日